

# SJ

中华人民共和国电子工业行业标准

SJ/T 10144~10146—91

---

## 可焊性测试仪技术条件

1991-04-02 发布

1991-07-01 实施

---

中华人民共和国机械电子工业部 发布

# 目 次

SJ/T 10144	焊球法可焊性测试仪技术条件 .....	(1)
SJ/T 10145	润湿称量法可焊性测试仪技术条件 .....	(9)
SJ/T 10146	焊槽法可焊性测试仪技术条件 .....	(18)

# 中华人民共和国电子工业行业标准

## 焊球法可焊性测试仪 技术条件

Specification for solderability  
tester by globule method

SJ/T 10144—91

---

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了焊球法可焊性测试仪的主要技术要求、试验方法和检验规则等。它适用于按 GB 2423.28 电工电子产品基本环境试验规程 试验 T 锡焊试验方法中规定的可焊性试验方法之一——焊球法原理制造的可焊性测试仪,它是制订产品标准、进行产品测试和验收的依据。

### 2 引用标准

- GB 2423.28 电工电子产品基本环境试验规程 试验 T 锡焊试验方法
- GB 2424.17 电工电子产品基本环境试验规程 锡焊试验导则
- GB 3785 声级计的电声性能及测式方法
- SJ 3209 可焊性测试仪通用技术条件

### 3 技术要求

#### 3.1 环境条件

应符合 SJ 3209 中 2.2 条的规定。

#### 3.2 使用性能

##### 3.2.1 连续工作时间

测试仪在规定的工作环境范围内,应能连续工作 8h。

##### 3.2.2 时间显示范围与误差

- a. 显示范围 0.00~9.99s;
- b. 误差  $\pm 0.01s$ 。

##### 3.2.3 测针升降架性能

计时支臂装有测针的升降架上下移动应灵活平稳,定位应准确,移动过程中不得有异常响声。

##### 3.2.4 夹线器功能

夹线器应能稳固地夹紧试样,测试过程中不得产生位移。